(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2006年2月9日 (09.02.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/014003 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/301 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01) *H01L 21/52* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/014494

(22) 国際出願日: 2005年8月2日 (02.08.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-226707 2004年8月3日 (03.08.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 古河電気工業株式会社 (THE FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内２丁目６番１号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 盛島 泰正 (MORISHIMA, Yasumasa) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内２丁目６番１号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 喜多 賢二 (KITA, Kenji) [JP/JP]; 〒4700135 愛知県日進市岩崎台２丁目２００２リビングタウン岩崎台Ｃ棟W Aichi (JP). 石渡 伸一 (ISHIWATA, Shinichi) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内２丁目６番１号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 山川 貴紀 (YAMAKAWA, Takanori) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内２丁目６番１号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).

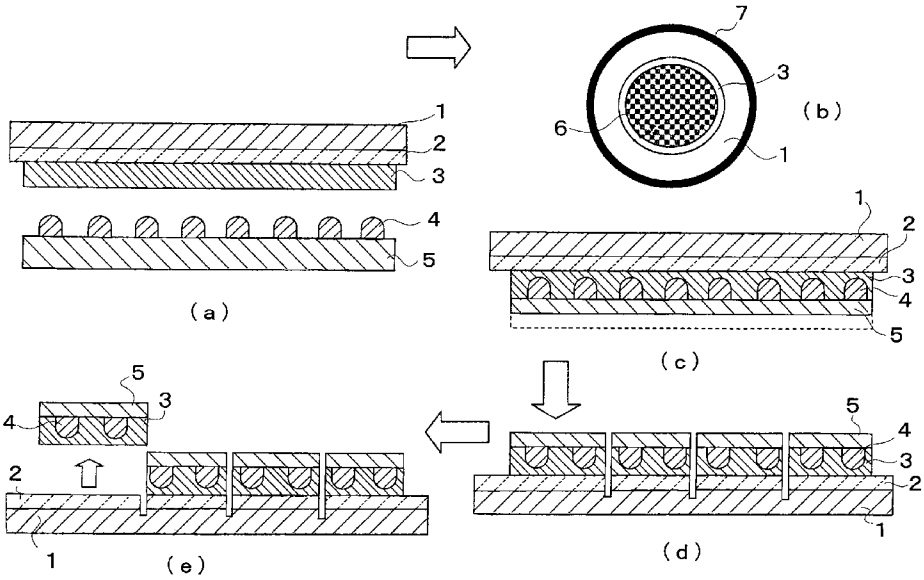
(74) 代理人: 飯田 敏三 (IIDA, Toshizo); 〒1050004 東京都港区新橋３丁目１番１０号 石井ビル３階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,

[続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE MANUFACTURING METHOD AND TAPE FOR PROCESSING WAFER

(54) 発明の名称: 半導体装置製造方法およびウエハ加工用テープ



(57) Abstract: A tape for processing wafer is provided with an adhesive agent layer (2) and a bonding agent layer (3) on a base material film (1). In a polishing process, a rear plane of a wafer circuit board (5) is polished, in a status where the tape is adhered on the wafer circuit board having a protruding metal electrode (4). In a dicing process, the wafer circuit board is separated into pieces. In a process of picking up the separated chips, the chip is picked up in a status where the bonding agent layer (3) is peeled from the base material film (1) and adhered to the chip.

(57) 要約: 基材フィルム(1)上に粘着剤層(2)および接着剤層(3)を有してなるウエハ加工用テープであって、該テープが凸型金属電極(4)付きウエハ回路基板(5)に貼合された状態で、該ウエハ回路基板の裏面を研削する研削工程と、該ウエハ回路基板を個片化するダイシング工程とがなされ、かつ、該個片化さ

[続葉有]

WO 2006/014003 A1

DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

れたチップをピックアップする工程において、前記接着剤層(3)が前記基材フィルム(1)から剥離し該チップに接着した状態でピックアップされるウエハ加工用テープ。